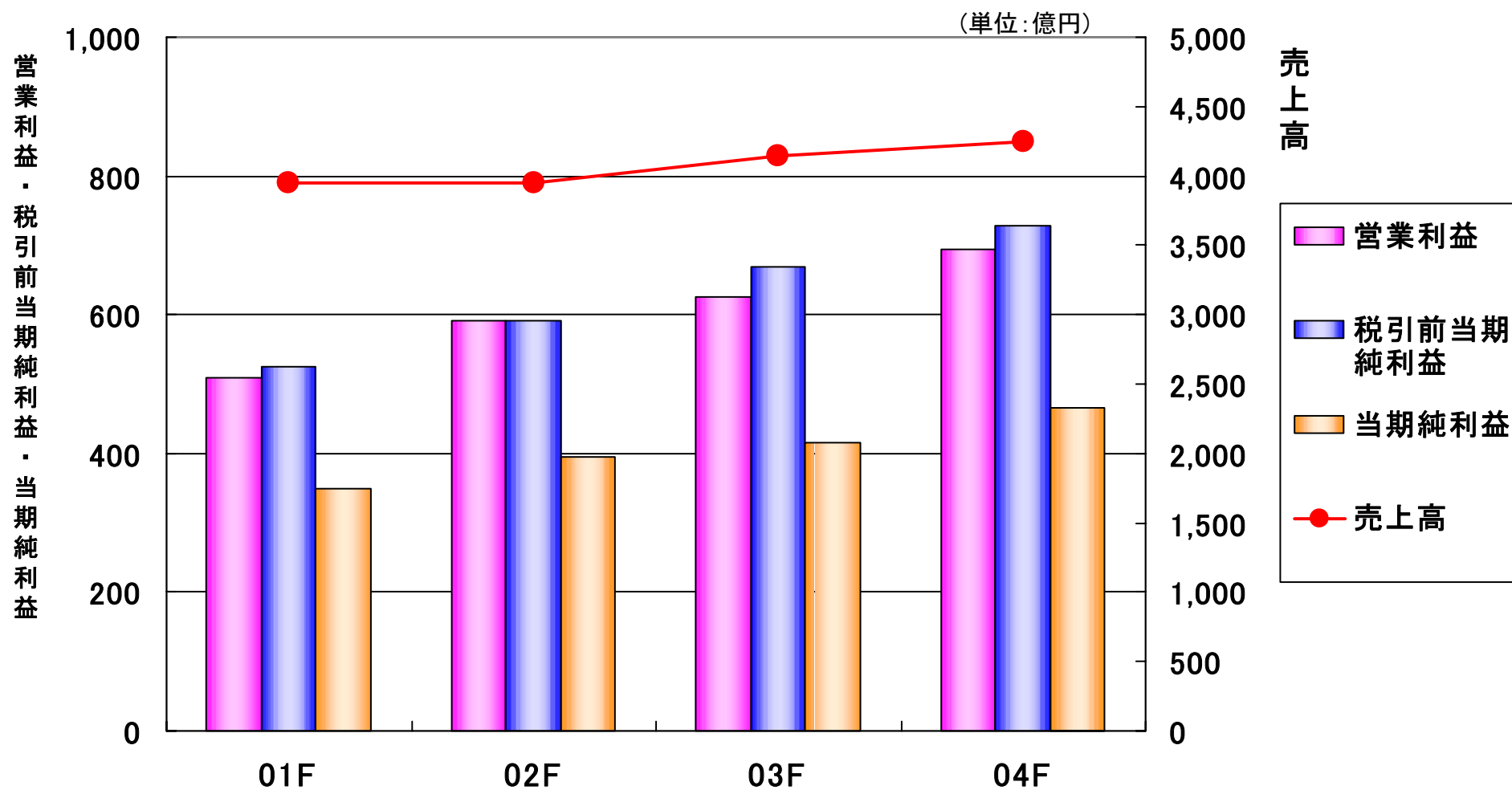


# ***INFORMATION MEETING***

## ***2005***



# 売上高及び利益の推移



※ 2003年度は、代行返上に伴う利益を除いている。

# 2004年度業績概況

	2003年度	2004年度	増減
売上高	4,142億円 (100.0)	4,245億円 (100.0)	+102億円 (+2.5%)
営業利益	742億円 (17.9)	695億円 (16.4)	▲47億円 (▲6.3%)
税引前利益	787億円 (19.0)	729億円 (17.2)	▲58億円 (▲7.3%)
当期純利益	485億円 (11.7)	466億円 (11.0)	▲20億円 (▲4.0%)

<以下、2003年度の厚生年金基金代行返上による影響額を除いた場合>

	2003年度	2004年度	増減
営業利益	625億円 (15.1)	695億円 (16.4)	+70億円 (+11.2%)
税引前利益	670億円 (16.2)	729億円 (17.2)	+59億円 (+8.8%)

※( )内の数値は売上高比または増減率

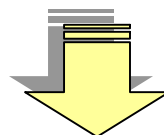
# 2005年度の電子機器の市場環境

- 最終需要の成長は前年度ほどは期待できない
- 部品価格の値下がりも依然として厳しい

一方で…

携帯電話市場(3GやBluetooth<sup>®</sup> (注)などの高機能化)  
パソコン市場(MPUのマルチコア化)  
デジタルAV機器市場(LCDTV、PDPTV、DVDレコーダ)  
カーエレクトロニクス市場

(注) Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です



大容量コンデンサ、小型コンデンサ、  
用途特化型コンデンサ、Bluetooth<sup>®</sup> モジュール、  
電源、センサなどで事業を拡大

# 2005年度の業績見通し

	2005年度 上期	2005年度 下期	2005年度 通期
売上高	2,150億円 (▲1.5%)	2,300億円 (+11.6%)	4,450億円 (+4.8%)
売上総利益	860億円 (▲2.9%)	905億円 (+12.7%)	1,765億円 (+4.5%)
営業利益	345億円 (▲9.6%)	405億円 (+29.2%)	750億円 (+7.9%)
税引前利益	360億円 (▲9.2%)	420億円 (+26.3%)	780億円 (+7.0%)
当期純利益	225億円 (▲9.5%)	265億円 (+22.0%)	490億円 (+5.2%)

※1 [四半期別売上高] Q1:1,070億円、Q2:1,080億円、Q3:1,180億円、Q4:1,120億円

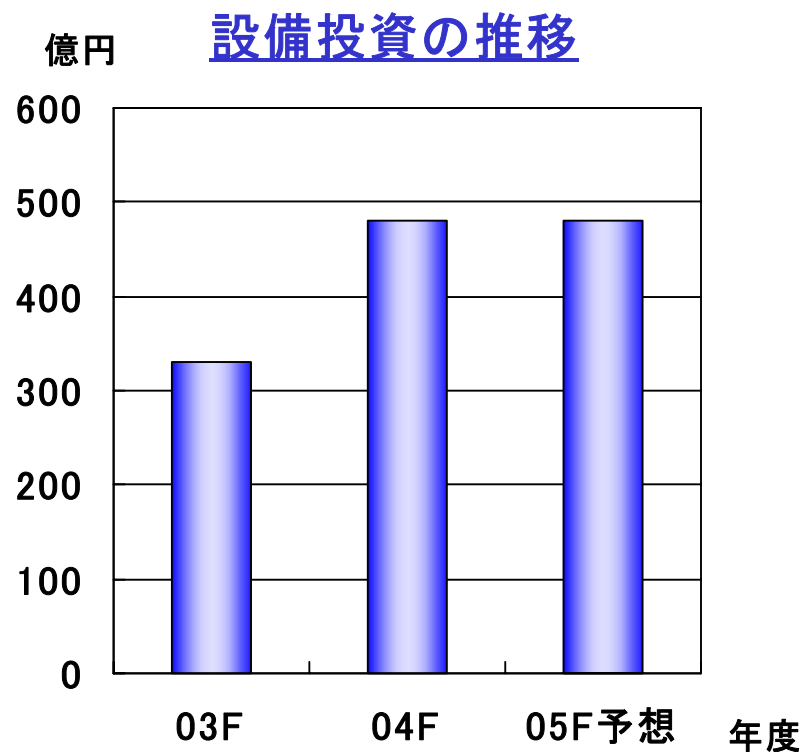
※2 ( )は、半期は前年同期比伸び率、通期は前期比伸び率

# 設備投資の推移

## 2005年度の設備投資額

480億円(前期と同水準)

- 2005年度に増加させる設備投資
  - ①主力製品の生産能力増強・合理化のための生産ライン設備投資
  - ②新製品創出のための研究開発投資
  - ③中国の無錫工場に新棟を建設  
積層セラミックコンデンサの一貫生産ラインを導入

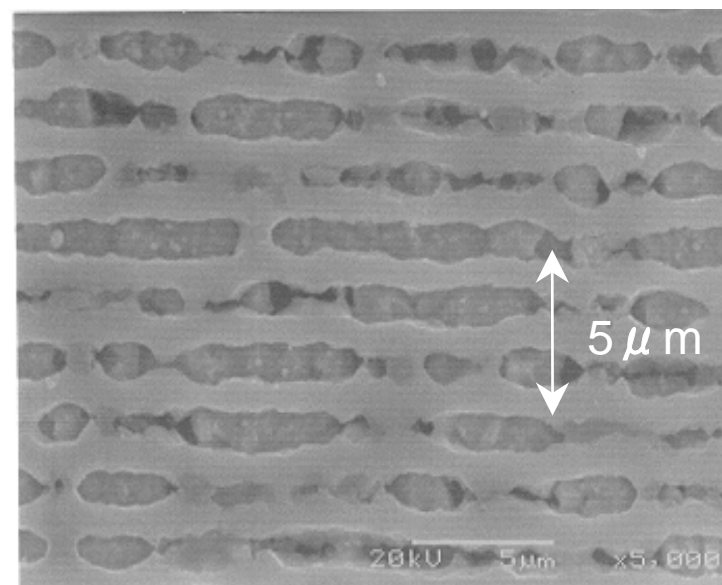


## 大容量品：薄層誘電体の量産技術を確立、売上急増

- 1.0  $\mu\text{m}$ の薄層誘電体を用いた大容量コンデンサの製品化
- 量産技術拡大、生産性向上
- 1608サイズ10  $\mu\text{F}$ 品、2012サイズ22  $\mu\text{F}$ 品の売上急増

小型大容量品の製品群を拡充

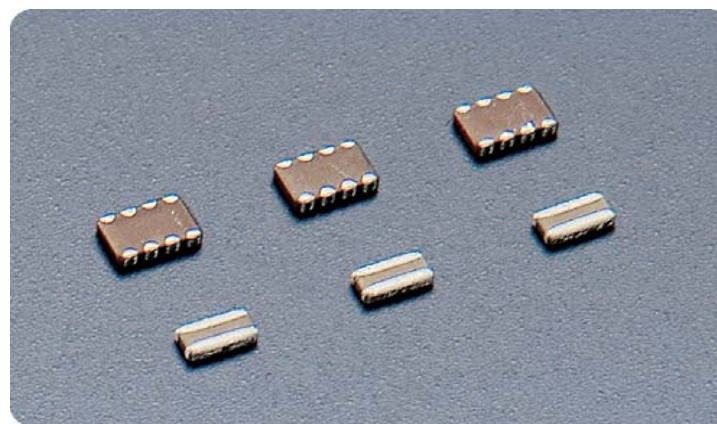
1  $\mu\text{m}$ 素子厚断面



- 異種コンデンサからセラミックコンデンサへの置き換え
- 急速に小型化、高機能化が進んでいるモバイル機器、パソコン、デジタルAV機器、ゲーム機での需要拡大

## 用途特化型：MPUマルチコア化による需要増

- 低ESLコンデンサ
  - 供給できるメーカーが限られ、当社のシェアが高い
  - マルチコア化によって、大容量コンデンサや低ESLコンデンサのMPU1個当たりの需要は増加
  - パソコン市場以外のゲーム機やサーバーなどの市場で需要が広がる

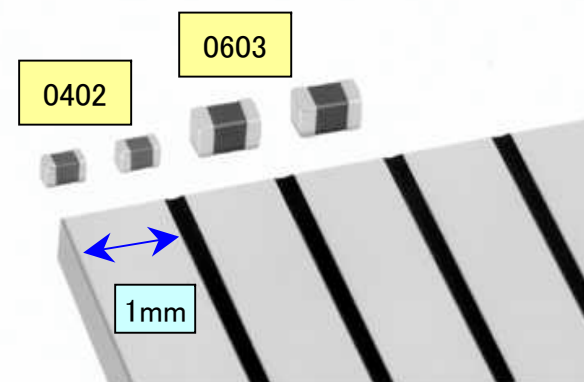


チップ積層セラミックコンデンサ(低インダクタンスタイプ) 8



## 小型品：電子機器の小型化、高機能化により需要拡大

- 0603サイズ
  - 携帯電話のパワーアンプモジュールから携帯電話メインボード、デジタルスチルカメラ、ゲーム機への広がり
  - 2004年度の売上数量は前期比で2倍以上
- 0402サイズ
  - 業界に先駆け2003年11月に商品化
  - 携帯電話のパワーアンプモジュールで採用始まる



0.4 × 0.2mm、0.6 × 0.3mmサイズ  
セラミックコンデンサ

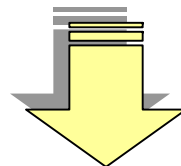
- Bluetooth<sup>®</sup> 市場

- 携帯電話のBluetooth<sup>®</sup> 機能搭載率上昇

2004年度下期:10%程度 → 2005年度下期:20%程度

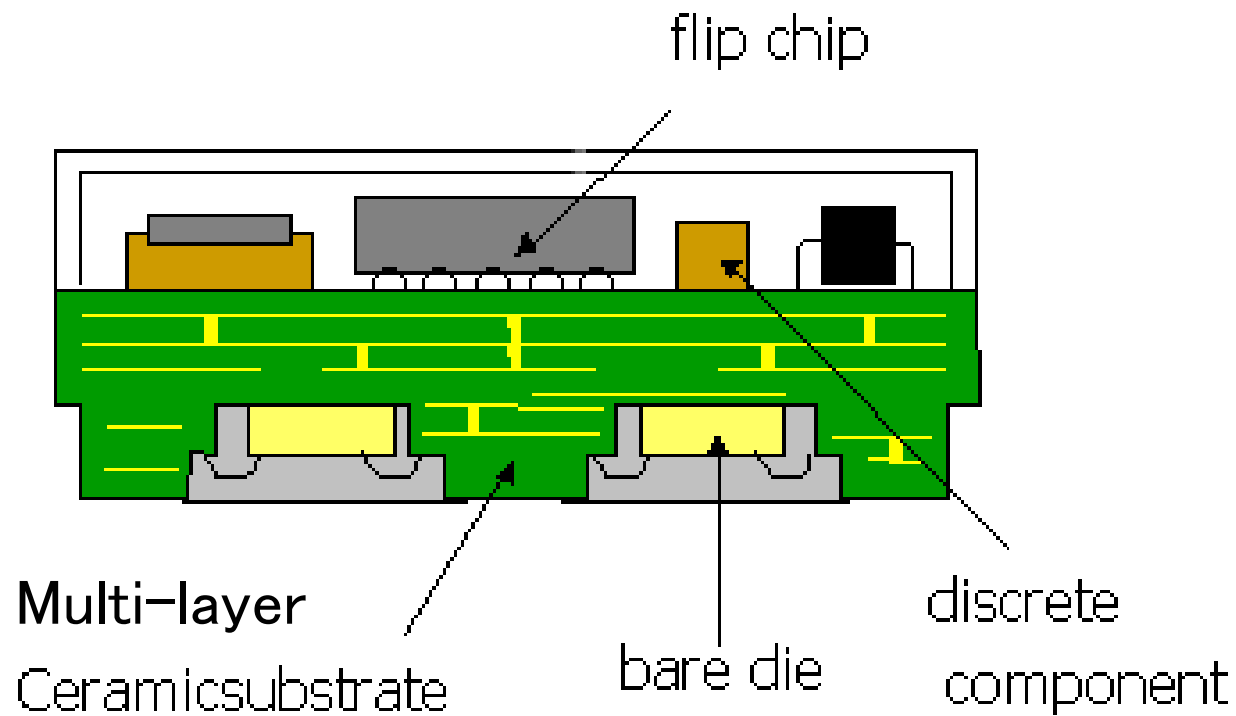
- Bluetooth<sup>®</sup> モジュール

- 大手得意先での採用増加
- 2005年度後半より原材料を内製化したLTCC(低温焼結セラミックス)基板を用いた製品割合が増加

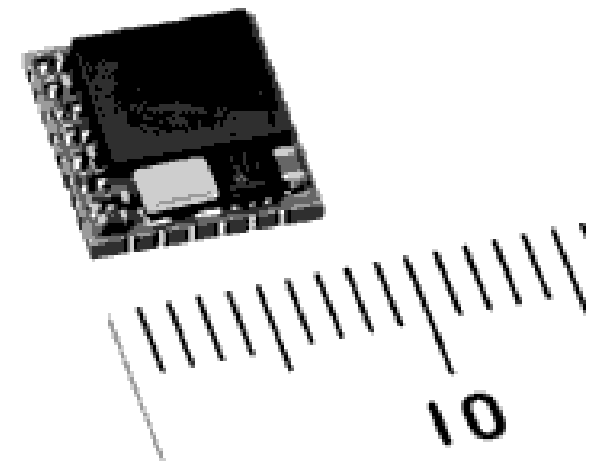


2005年度に売上の大幅増加を計画

## <構造図>

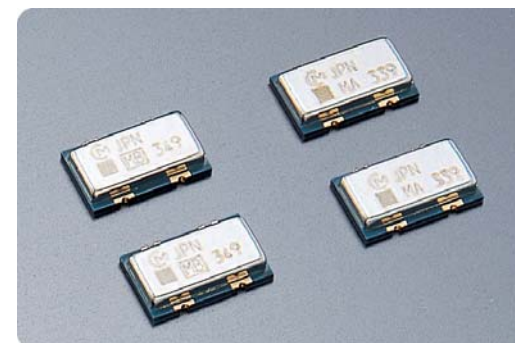


## <写真>

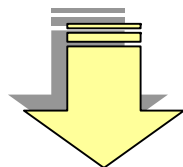
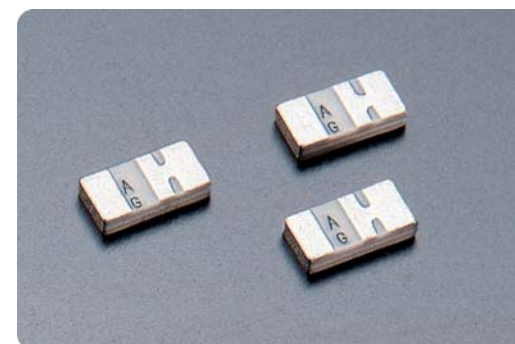


# センサ関連製品

- ジャイロスター<sup>®</sup>
  - 手ブレ補正機能用として  
デジタルスチルカメラで採用拡大



- ショックセンサ
  - HDD搭載のモバイル機器拡大に伴い、  
振動検知用として売上が伸長
  - 有効なパテント保有、シェアが高い



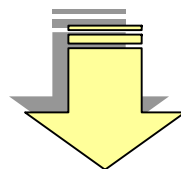
センサ関連製品は2005年度も10%以上の売上増加を計画

- 回路設計技術、生産技術により、省エネルギーで効率が高く、小型、薄型の電源を製品化
- 当初は、FAXやコピー機向けを中心に電源事業に取り組む
- 市場が拡大しているPDPや液晶ディスプレイなどのデジタル機器向けで売上が伸長

蓄積した回路設計技術を展開、外部資源も有効に活用し、電源事業を強化

## ノイズ対策部品の需要の高まり

電子機器のデジタル化、高機能化に伴うノイズの増大



–チップインダクタ、チップコモンモードチョークコイル、チップ3端子型コンデンサなどのEMI除去フィルタや積層/フィルム/巻線構造のチップコイルなど幅広いラインアップ

当社のノイズ対策部品は、  
過去数年間にわたり着実に増加

## ノイズ対策部品ラインアップ

- チップインダクタ (BLM)
  - DVDレコーダでは約70個/台の需要
- チップ3端子型コンデンサ (NFM)
  - 電源ラインのノイズ対策に特性を発揮
  - DVDレコーダでは約10個/台の需要
- チップコイル (LQW/LQG/LQP)
  - 携帯電話では約30個/台の需要
- チップコモンモードチョークコイル (DCC)
  - 高速インターフェースで発生するノイズを効果的に除去



BLM Series



NFM21P Series

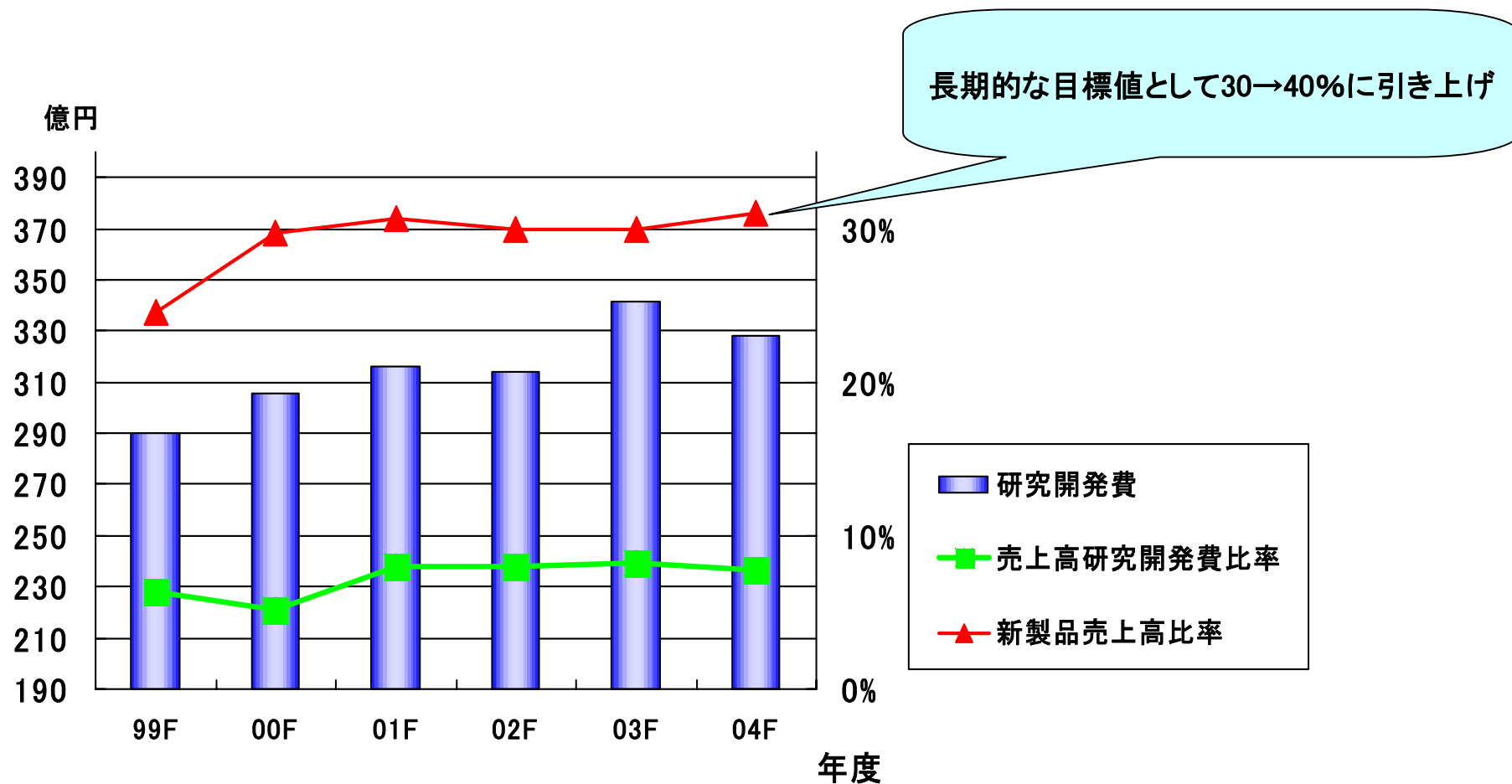


LQW/LQG/LQP Series



DLP/DLW31S Series

# 研究開発費の推移(連結)



※上表の2003年度研究開発費は、厚生年金基金代行返上による一時処理額14億円を含んでいる。



## 「ユビキタス社会」の進展による 無線通信市場の広がり

- ・携帯電話などモバイル無線通信機器は大きな市場を創造
- ・無線通信技術は自動車からホームセキュリティに至るまでさまざまなシチュエーションで拡大



ユビキタス社会の進展とともに、  
エレクトロニクス技術は更なる進化を続ける

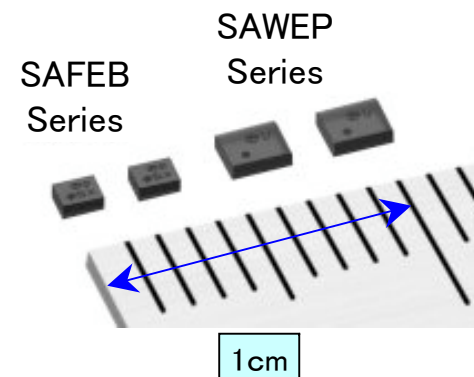
# 新市場への取り組み

## 無線通信市場の電子部品で高い優位性

- コンデンサ、ノイズ対策部品、各種のフィルタ

## 表面波フィルタでの当社シェアの上昇

- チップサイズパッケージ(CSP)技術を応用
- 業界最小クラスの表面波フィルタを商品化



## LTCCモジュール製品による高機能化と小型化の両立

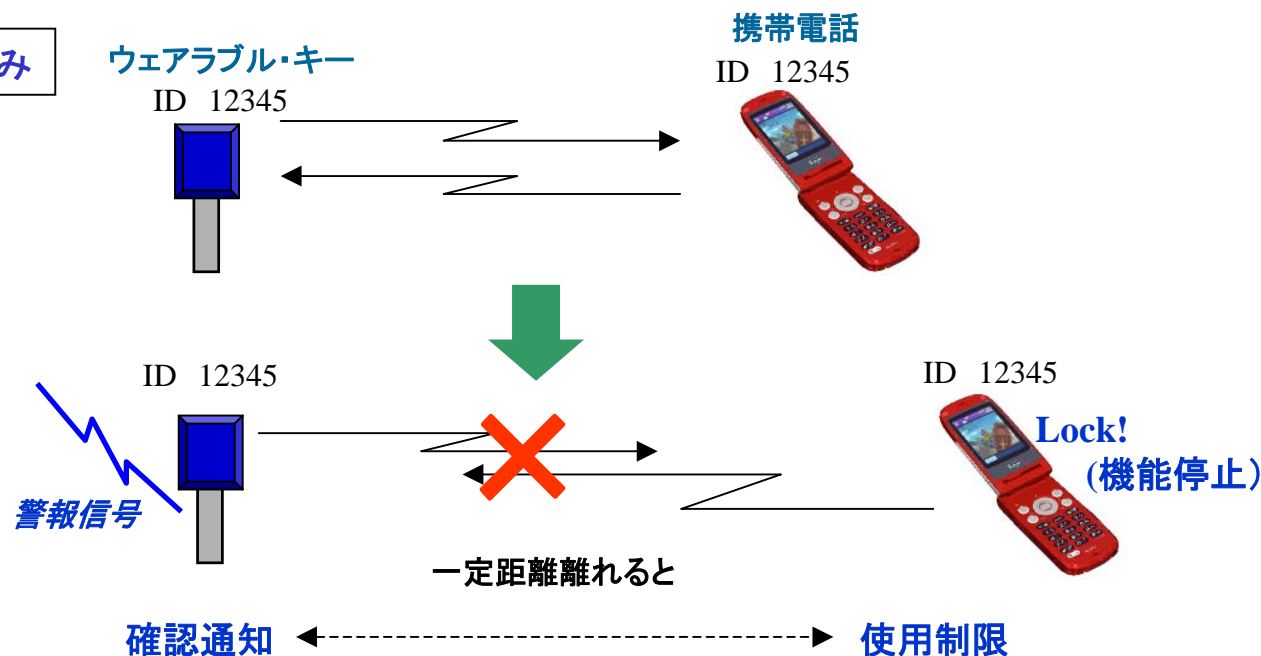
- Bluetooth<sup>®</sup>モジュールにおける付加価値の取り込み
- 世界最小クラスの無線LANモジュールの製品化

# 新市場への取り組み

## 常時認証機能を備えたマルチタスク通信モジュールの製品化

- 電子マネー機能搭載や膨大な情報量を扱う情報端末の登場
- セキュリティのための本人認証技術が重要
- 携帯電話などのセキュリティ用途として市場規模も大きい

### ワイヤレス個人認証の仕組み



## 無線通信機器に不可欠なアンテナ事業を強化

- マルチバンド対応の携帯電話の拡大による需要の増大
- セラミック粉と耐熱性有機材料を混練した複合誘電体材料「セラブリッド™」を用いたメインアンテナを中心に事業化を進める



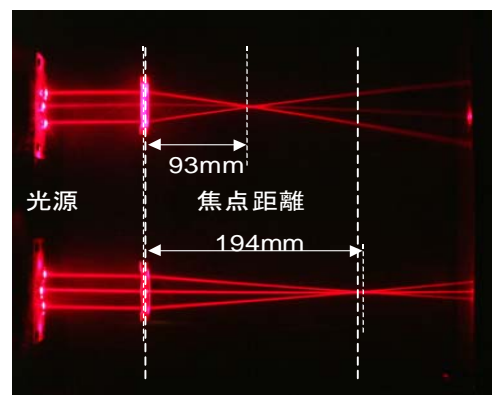
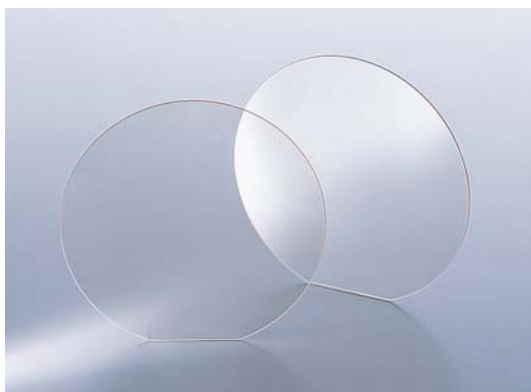
セラブリッド™を利用したアンテナ

## 地上デジタル小型チューナ

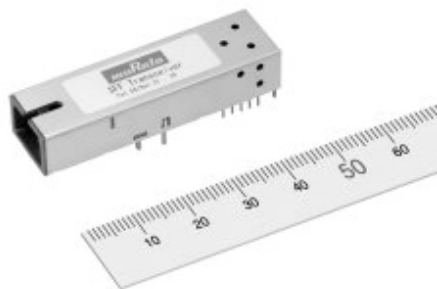
- 小型化技術を生かし地上デジタル小型チューナに注力

## 高周波技術からミリ波技術、光事業を展開

- 透光性セラミックス(ルミセラ<sup>®</sup>)

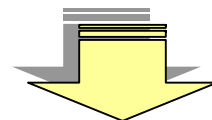


- 光トランシーバモジュール



## 自動車市場への取り組み

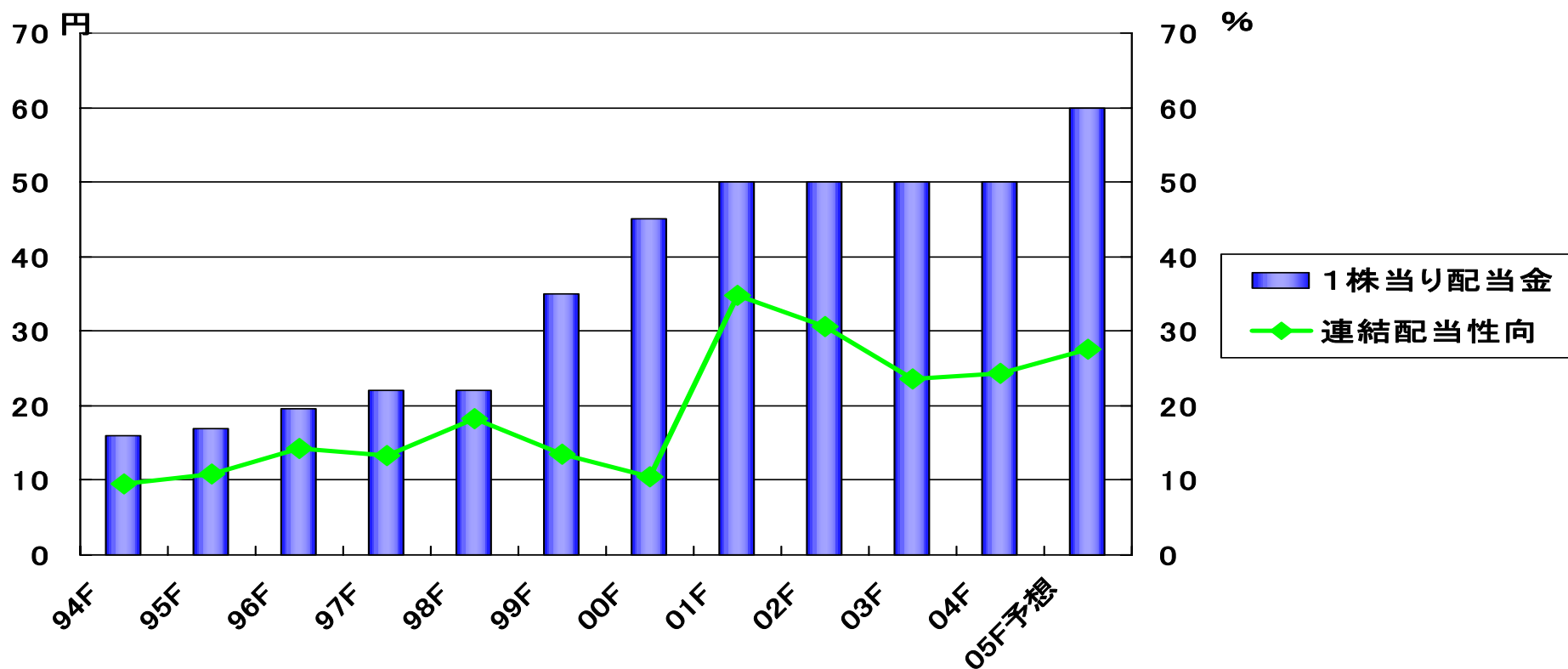
- ①情報通信 [ カーナビへの取り組み、車内LAN・ETC(Electronic Toll Collection)・RKE(Remote Keyless Entry)・テレビチューナなどでの高周波技術の活用、LTCC基板の需要拡大 ]
- ②安 全 [ TPMS(Tire Pressure Monitoring System)ソリューション技術 ]
- ③環 境 [ 燃料電池向け濃度センサ、エンジン制御アクチュエータの開発 ]



売上高の構成比率12% 更なる売上の増加を期待

# 1株当たり配当金・連結配当の推移

2005年度は10円の増配(予定)  
1株当たり配当金 98年度:22円 → 05年度(予想):60円



## – 自己株式取得実績

・ 2002年 7月～2005年 5月 2,060万株 1,133億円  
(発行済株式数の8%)

## – 自己株式の消却

・ 1,900万株を消却



# 総還元性向

	2002 年度	2003 年度	2004 年度	計
①当期純利益	395 億円	485 億円	466 億円	1,346 億円
②自己株式取得額	481 億円	321 億円	272 億円	1,075 億円
③配当額	119 億円	116 億円	113 億円	348 億円
④配当性向	30.6%	23.7%	24.4%	25.9%
⑤自己株式取得額÷当期利益	122.0%	66.2%	58.3%	79.8%
⑥総還元性向(②+③)÷①	152.6%	89.8%	82.7%	105.7%

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定していない事実の記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があります。これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1) 当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2) 原材料等の価格変動及び供給不足、(3) 為替レートの変動、(4) 変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5) 当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6) 各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7) 偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

*muRata*